证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-081
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）

● 新增项目名称：晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。

● 变更募集资金投向的金额：本次募集资金变更前后情况如下：

单位：万元

变更前项目名称	变更前计划使用募集资金金额	变更后项目名称	变更后计划使用募集资金金额
晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	130,000.00	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	18,441.54
CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00
补充流动资金	34,000.00	补充流动资金	34,000.00
—	—	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	83,482.95
—	—	高性能图像传感器芯片测试扩产项目	20,899.15
—	—	硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目	7,316.53
合 计	244,000.00	合 计	244,140.18

注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目建设期 24 个月，达产后年均预计实现销售收入 42,120.00 万元，项目静态回收期（税前）6.84 年；高性能图像传感器芯片测试扩产项目建设期 18 个月，达产后年均预计实现销售收入 10,223.66 万元，项目静态回收期（税前）6.65 年；硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目建设期 24 个月，达产后年均预计实现销售收入 20,420.40 万元，项目静态回收期（税前）5.83 年。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）于 2021 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 244,000.00 万元（以下简称“本次募集资金”），扣除承销费用后的募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10003 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集资金金额
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	183,919.98	130,000.00
2	CMOS 图像传感器研发升级	136,413.84	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
	合 计	354,333.82	244,000.00

公司根据发展战略和实际情况，拟对募投项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”投资计划进行调整，其余募集资金投资项目保持不变。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已累计使用本次募集资金 14,890.17 万元，募集资金使用率为 11.45%；该项目募集资金专户产生利息收入 140.18 万元，募集资金专户余额为 115,250.00 万元，募集资金投资项目变更后，其中 3,551.37 万元将继续用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目投资，111,698.63 万元拟变更用于晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目，占本次原募集资金总额的比例为 45.78%。

本次募集资金变更前后情况如下：

单位：万元

变更前项目名称	变更前计划使用募集资金金额	变更后项目名称	变更后计划使用募集资金金额
晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	130,000.00	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	18,441.54
CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00
补充流动资金	34,000.00	补充流动资金	34,000.00
—	—	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	83,482.95
—	—	高性能图像传感器芯片测试扩产项目	20,899.15
—	—	硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目	7,316.53
合 计	244,000.00	合 计	244,140.18

注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

二、本次部分募投项目变更的具体情况

本次变更的募投项目为晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期），具体情况如下：

（一）原项目计划投资情况

原项目于 2018 年 8 月批准立项，并于 2019 年 12 月开始实施，计划总投资额为 183,919.98 万元，建设期为 30 个月，实施主体为豪威半导体（上海）有限责任公司，预计达产后年收入 74,189.81 万元，年均净利润 20,516.49 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目仍处于建设过程中。

（二）原项目实际投资情况

晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）投入金额主要由以下部分构成：

1、根据中国证监会于 2019 年 6 月 5 日签发的证监许可[2019]1001 号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向五位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68 元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元（以下简称“前次募集资金”）。公司将前次募集资金中的 7,863.16 万元用于支付中介机构费用，剩余 32,551.55 万元悉数用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）的投入。截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已使用完毕。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）共使用本次募集资金 14,890.17 万元，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 115,109.83 万元，上述资金存储于豪威半导体（上海）有限责任公司开立的募集资金专户中。

截至 2021 年 6 月 30 日，原项目累计投入募集资金金额合计约为 47,441.72 万元。公司已部分完成该项目，按调整后的投资规划将预计实现新增 12 吋晶圆测试产能和 12 吋晶圆重构产能各 18 万片/年。

（三）变更的具体情况及原因分析

原募集资金投资项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”实施内容为构建晶圆测试及晶圆重构生产线，实现新增 12 吋晶圆测试量 42 万片/年，12 吋晶圆重构量 36 万片/年，项目达产后预计实现年均销售收入 74,189.81 万元，年均净利润 20,516.49 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已部分完成该项目，按照调整后的投入规划，公司将新增 12 吋晶圆测试产能和 12 吋晶圆重构产能各 18 万片/年。

公司在制定原募集资金投资项目投资计划时，系基于公司晶圆测试及晶圆重构的整体产能需求进行资金投入规划，以期在项目建设期结束后公司能实现大部分晶圆测试及晶圆重构环节自产。在全球晶圆产能供需关系趋于紧张的环境下，与供应链持续稳定的合作关系有助于公司更积极主动的应对端潜在的风险，因此公司将继续保持与境外代工厂紧密合作关系，合理分配公司自产及委外加工的晶圆测试及晶圆重构产能结构，整体来看公司自产及委外代工的产能已能够满足公司中短期晶圆测试和晶圆重构环节的需求。

公司调整晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）的投入，一方面有利于公司在降低成本的同时保障投资效率，另一方面也有利于公司维护与其他代工厂的合作关系，促进公司产业技术升级，保障公司在晶圆测试及晶圆重构环节供应链的多样性。公司暂时不再使用募集资金扩充晶圆测试及晶圆重构产能，未来将根据市场情况择机以自有资金继续投资建设。

在目前全球半导体行业供应链不确定性加强的形势下，为应对上下游可能出现的突发变化，提升公司供应链的安全性和公司整体经营的稳定性，公司决定将原计划用于投资“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的部分资金优先用于保障供应链安全和市场亟需的生产环节投资项目。

经过公司充分论证，为了适应新形势下的竞争格局，充分提升募集资金使用效率，决定将计划用于“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的部分募集资金 111,698.63 万元，用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。上述项目符合公司战略规划，是公司保障供应链安全及提升产品竞争力的重要举措，上述项目的实施将大幅提升公司经营的稳定性及持续性，提升公司整体行业竞争力，符合公司整体战略规划。

募投项目变更前后效益测算如下：

单位：万元

项目	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）（变更后）	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	高性能图像传感器芯片测试扩产项目	硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目	变更后项目合计	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）（变更前）
达产后年收入	34,342.70	42,120.00	10,223.66	20,420.40	107,106.76	74,189.81
达产后年均净利润	12,425.22	10,354.88	2,787.64	2,695.71	28,263.45	20,516.49

综上，根据可研报告测算，此次变更后的募集资金投资项目达产后年收入合计 107,106.76 万元，达产后年均净利润合计 28,263.45 万元，高于原募投项目的效益，因此本次募投项目变更能够提升募投项目的预计效益，提升公司整体盈利能力。

三、此次募集资金变更后拟投资的新项目情况

（一）晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目

1、项目概况

晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目实施主体为豪威半导体（上海）有限责任公司，项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路。通过本项目的建设，将具备晶圆彩色滤光片和微镜头封装的生产能力。目前公司圆彩色滤光片和微镜头封装均通过委托第三方生产方式生产，项目建成后能够改变公司全部以委外方式进行晶圆彩色滤光片和微镜头封装的竞争格局，控制公司产品成本及生产周期，保障公司供应链安全，提升公司整体竞争力。

该项目建设期 24 个月，达产后年均预计实现销售收入 42,120.00 万元，项目静态回收期（税前）6.84 年；

2、项目资金分配

单位：万元

序号	投资项目	金额	占比
1	建设投资	83,482.96	94.86%
2	预备费	2,504.49	2.85%
3	铺底流动资金	2,018.86	2.29%
4	合 计	88,006.30	100.00%

3、项目投资进度

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算			占比
		T+1	T+2	合计	
1	建设投资	53,093.92	30,389.04	83,482.96	94.86%
2	预备费	1,592.82	911.67	2,504.49	2.85%
3	铺底流动资金	–	2,018.86	2,018.86	2.29%
4	项目总投资	54,686.74	33,319.56	88,006.30	100.00%

4、项目预计效益情况

根据可行性研究报告，该项目达产后将实现 24 万片/年的产能。项目达产后年均收入为 42,120.00 万元，所得税 1,148.14 万元，净利润 10,354.88 万元。

5、项目必要可行性分析

（1）目前 CMOS 图像传感器产业仍保持高速增长趋势，豪威科技作为全球领先的三大主要图像传感器供应商之一，通过实施本项目可以抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇，实现公司的快速发展。

（2）近年来，美国发动的贸易摩擦造成了集成电路产业链的不稳定，伴随疫情带来的影响，集成电路供给端受到较大的冲击。考虑到集成电路行业对国民经济及社会发展的战略性支柱作用以及中美贸易摩擦等因素，集成电路国产化的需求更具紧迫性。通过本项目建设，利用公司现有技术和管理优势，将晶圆彩色滤光片和微镜头封装由外协加工转变为自行生产，从而减少供应链风险，提升公司的竞争力。

（3）通过本项目建设，公司将引进先进的自动化生产线，配备高素质、经验丰富的生产及技术人员，打造一个空间结构布局合理、工艺精度高的晶圆光学微镜头生产基地，满足公司现有产品的 CMOS 图像传感器封装需求。本项目的实施不仅可以提高对客户需求的响应速度，全面提升公司的产品过程控制能力，更好的满足下游多样化的市场需求，还可以大幅降低公司委外加工成本，提升公司盈利能力。

（二）高性能图像传感器芯片测试扩产项目

1、项目概况

高性能图像传感器芯片测试扩产项目实施主体为豪威半导体（上海）有限责任公司，项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路。公司通过该项目实施，可以实现 30 万像素至 6,400 万像素，从消费类、安防类、到汽车专用芯片的成品测试。对于消费类产品，可以测试高像素、高传输速率的产品；对于安防类，可以测试 850nm 和 940nm 两个红外光的测试；对于汽车类芯片，可以覆盖安全要求、高动态范围以及 LED 闪烁消除等功能测试。

该项目建设期 18 个月，达产后平均预计实现年均销售收入 10,223.66 万元，项目静态回收期（税前）6.65 年。

2、项目资金分配

单位：万元

序号	投资项目	金额	占比
1	建设投资	20,899.15	93.68%
2	预备费	626.97	2.81%
3	铺底流动资金	783.51	3.51%
4	合 计	22,309.63	100.00%

3、项目投资进度

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算			占比
		T+1	T+2	合计	
1	建设投资	12,969.57	7,929.58	20,899.15	93.68%
2	预备费	389.09	237.89	626.97	2.81%
3	铺底流动资金		783.51	783.51	3.51%
4	项目总投资	13,358.65	8,950.98	22,309.63	100.00%

4、项目预计效益情况

根据可行性研究报告，该项目达产后将实现 22,519 万颗/年的产能。项目达产后年均收入为 10,223.66 万元，所得税 325.77 万元，净利润 2,787.64 万元。

5、项目必要可行性分析

（1）目前 CMOS 图像传感器产业仍保持高速增长趋势，豪威科技作为全球领先的三大主要图像传感器供应商之一，通过实施本项目可以抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇，实现公司的快速发展。

（2）本项目的实施，有利于公司在芯片测试方面的产业布局，有效提升公司综合竞争力和创新发展水平，并在此基础上实现公司营业收入和利润稳步、持续、快速增长，有利于公司的可持续发展，实现战略目标。

（3）通过本项目建设，公司将提升高性能图像传感器芯片测试能力，不断向纵深拓展业务链，减少外协环节，提升公司的收入水平和盈利能力，为公司未来发展奠定良好的基础。

（三）硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目

1、项目概况

硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目实施主体为豪威半导体（上海）有限责任公司，项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路。硅基液晶投影显示芯片是近些年兴起的高科技产品，采用半导体硅材料为基底，融合液晶显示所需要的灌注技术，采用一体化的驱动设计，具有体积小、像素密度大、像素间距窄、功耗低、显示效果好等特点，在可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、VR/AR、汽车和医疗器械等领域被广泛应用，尤其在新兴的 AR/VR 近眼显示和汽车抬头显示具有压倒性的技术优势。公司掌握从产品设计、晶圆制造、液晶封装、成品检验的全产品线的核心技术，从工艺制程研发到制造供应都可以在第一时间给予市场响应。

该项目建设期 24 个月，达产后平均预计实现年均销售收入 20,420.40 万元，项目静态回收期（税前）5.83 年。

2、项目资金分配

单位：万元

序号	投资项目	金额	占比
1	建设投资	7,316.53	80.17%
2	预备费	219.50	2.41%
3	铺底流动资金	1,590.04	17.42%
4	合 计	9,126.07	100.00%

3、项目投资进度

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算			占比
		T+1	T+2	合计	
1	建设投资	5,121.57	2,194.96	7,316.53	80.17%
2	预备费	153.65	65.85	219.50	2.41%
3	铺底流动资金		1,590.04	1,590.04	17.42%
4	项目总投资	5,275.22	3,850.85	9,126.07	100.00%

4、项目预计效益情况

根据可行性研究报告，该项目达产后将实现 120 万颗/年的产能。项目达产后年均收入为 20,420.40 万元，所得税 174.50 万元，净利润 2,695.71 万元。

5、项目必要可行性分析

（1）随着消费者对新一代可穿戴浸入式虚拟现实/现实增强（AR/VR）设备的渴望以及 5G 网络的广泛应用，未来硅基液晶显示市场需求将呈爆发式增长趋势，从而带动硅基液晶显示芯片市场规模不断提升。

（2）通过本项目的建设，将有效促进现有硅基液晶投影显示芯片产品的技术升级和生产制造能力，将持续提升公司在图像传感器芯片业务的领先地位。

（3）通过本项目的建设，有利于公司在 AR/VR、汽车抬头显示等新兴应用领域的的产业布局，有效提升公司综合竞争力和创新发展水平，并在此基础上实现公司营业收入和利润稳步、持续、快速增长，有利于公司的可持续发展，实现战略目标。

四、实施新项目的风险

（一）行业周期性风险

由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，进而导致了半导体产品的生命周期不断缩短。公司的经营业绩可能会因半导体行业周期性而产生较大的波动。新募投项目涉及新增生产环节以及现有生产能力的扩充等环节，公司已经具备实施上述募投项目的技术及工艺能力，若半导体行业呈现周期性变化或技术工艺发生重大变化，项目经营情况可能不及预期。

公司将进一步提升管理水平，随时跟踪市场信息和行业动态，并进行相应的分析处理，提前分析预测各下游行业周期和产品趋势，及时调整决策思路，以避免或降低行业周期波动对公司业绩增长所造成的影响；另一方面，公司通过生产管理、开发新材料、新工艺、采用新设备等方式降低成本，在为客户提供高性价比产品和优质服务的同时确保盈利空间；加大市场开拓力度，并提升公司品牌知名度及市场竞争力。

（二）运营及技术风险

此次公司拟通过实施“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”三个项目，实现部分生产环节委外加工比例的下降，降低产品生产成本，提升整体盈利能力。但由于半导体行业技术具有技术难度大、工艺变化及迭代速度快等特点，通常专业化分工能够使得各生产商能够专注于自身领域技术的发展及研发的深入，如公司在实施上述项目时不能及时掌握最新的技术及工艺，则可能对公司产品的生产造成一定影响。

公司目前在全球多地设立研发中心，有着强大的研发团队，团队中的核心技术人员均在全球知名半导体公司担任过技术、运营等高层管理人员，同时公司与代工厂商有深入的技术往来，对项目的实施具有丰富的技术支持及保障。同时公司也会不断加强技术及工艺的研发，以保障技术领先性。

（三）募投项目的实施及运营风险

公司募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，并进行了可行性分析。募集资金投资项目的实施有利于进一步扩大服务规模、降低运营成本、提高研发实力、提升公司核心竞争力，对开拓新市场和抵御市场风险等方面都具有重要的意义。由于项目从论证到实施、再到建成投产需要较长时间，政策环境、市场规模、投资成本等可能发生变化，存在着项目不能顺利实施或建成后不能完全达到预期经济效益的风险。

（四）募投项目实施的审批风险

本次募集资金变更后的新投资项目中，“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”不需要履行环评审批手续；“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”已取得上海市松江区环境保护局关于环境影响评价报告表的审批意见；“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”的环评手续尚未办理完毕。如“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”不能取得环评审批手续，则该项目存在无法实施的风险。

五、新项目所需的审批及备案程序

（一）晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目

本项目由专业机构出具了可行性研究报告，并已在松江出口加工区管委会完成该项目备案，并取得了《上海市外商投资项目备案证明》。本项目尚需履行环境影响评价手续，环境影响评价手续正在办理中。

（二）高性能图像传感器芯片测试扩产项目

本项目由专业机构出具了可行性研究报告，并已在松江出口加工区管委会完成该项目备案，并取得了《上海市外商投资项目备案证明》。本项目的建设以及在以后经营过程中，产生的环境污染物主要有少量噪音、固体废弃物等，按照国家相关规定要求处理后，不会对周边环境产生不良影响，无需履行环境影响评价手续。

（三）硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目

本项目由专业机构出具了可行性研究报告，并已在松江出口加工区管委会完成该项目备案，并取得了《上海市外商投资项目备案证明》和《上海市松江区环境保护局关于豪威半导体（上海）有限责任公司硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）环境影响报告表的审批意见》。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经审慎查验，公司独立董事认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目充分提升了募集资金使用效率，实现了资金配置最优化和效益最大化，是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次募投项目变更事项履行了相应的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，亦不构成关联交易。因此，公司独立董事同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审慎查验，公司监事会认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目的变更，并将该事项提交至公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

1、公司变更可转换公司债券募投项目的议案已经通过公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过，独立董事已发表了同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次公司可转换公司债券募投项目变更事项尚需提交股东大会及可转换公司债券债券持有人会议审议；

3、公司本次变更可转换公司债券募投项目事项是基于当前市场形势、公司实际经营情况、未来业务发展与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出的谨慎决定，本次变更有利于提升公司经营的稳定性及持续性，提升公司整体行业竞争力，符合公司整体战略规划。

综上，本保荐机构对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目尚需提交至公司债券持有人会议及股东大会审议。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-082
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2021 年 7 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议于 2021 年 7 月 8 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司董事会同意减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（2021-081）。

（二）审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

为进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及配套通知要求，董事会同意对《上海韦尔半导体股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海韦尔半导体股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请择日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会提请择日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次债券持有人会议，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第一次债券持有人会议审议。债券持有人会议召开具体时间及安排另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-083
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于 2021 年 7 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 8 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

经审慎查验，公司监事会认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次募投项目的变更，并将该事项提交至公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（2021-081）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：临 2021-062 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司2021 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 1.西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,680 万元到 7,200 万元，与上年同期相比将增加 4,482 万元到 5,002 万元，同比增加 203.91%到 227.57%。

● 2. 公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,461 万元到 6,981 万元，与上年同期相比将增加 4,633 万元到 5,153 万元，同比增加 253.48%到 281.93%

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告时间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,680 万元到 7,200 万元，与上年同期相比将增加 4,482 万元到 5,002 万元，同比增加 203.91%到 227.57%。

2.公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,461 万元到 6,981 万元，与上年同期相比将增加 4,633 万元到 5,153 万元，同比增加 253.48%到 281.93%。

3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,198 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,827.82 万元。

（二）每股收益：0.04 元。

三、本期业绩预增的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要受以下因素的综合影响：

（一）主营业务的影响

2021 年上半年业绩上升原因：一方面受有色金属市场价格影响，公司主要产品铅锑精矿含银、锌价格较去年同期涨幅较大；另一方面本期生产量较去年增长导致销售收入增加。

（二）非经常性损益的影响

本期收到财政扶持款 63.75 万元，去年同期收到财政扶持款 889.34 万元

（三）会计处理的影响

公司不存在会计处理的影响

（四）其他

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日

证券代码：600093 证券简称：*ST 易见 公告编号：2021-072

易见供应链管理股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

??中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的立案调查尚在进行中，尚未有结论性意见，公司将积极配合调查，履行信息披露义务。

??目前公司正在与云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）积极沟通，全面核查资金占用情况，后续将根据核查结果履行信息披露义务。

??经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021 年 7 月 9 日至 7 月 13 日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，截至 2021 年 7 月 13 日，公司股票收盘价格为 4.59 元/股，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2020 年 12 月修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经自查，目前公司日常经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司控股股东及实际控制人问询，目前公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、风险提示

（一）2021 年 5 月 14 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前调查工作尚在进行中，尚未有结论性意见。公司将积极配合中国证监会的调查工作，按照相关要求履行信息披露义务。

（二）2021 年 6 月 20 日，公司收到股东九天控股来函确认，其对公司及子公司构成资金占用 42.53 亿元。2021 年 7 月 6 日，九天控股收到云南证监局责令改正措施决定，要求其在收到决定之日起 30 日内提交有关资金占用的书面整改报告。目前公司正积极与九天控股沟通，全面核查资金占用情况，后续将按照相关要求履行信息披露义务。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，目前公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日

证券代码：600614 900907 证券简称：退市鹏起 退市鹏 B 公告编号：临 2021-073

鹏起科技发展股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票已被上海证券交易所决定终止上市，上海证券交易所将在退市整理